

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(10) 国际公布号
WO 2025/066699 A1

(43) 国际公布日
2025 年 4 月 3 日 (03.04.2025)

(51) 国际专利分类号:
C25D 17/00 (2006.01) **C25D 21/16** (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2024/114174

(22) 国际申请日: 2024 年 8 月 23 日 (23.08.2024)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202311274178.0 2023 年 9 月 27 日 (27.09.2023) CN

(71) 申请人: 盛美半导体设备 (上海) 股份有限公司 (ACM RESEARCH (SHANGHAI), INC.) [CN/CN];
中国上海市浦东新区中国 (上海) 自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 201203 (CN)。

(72) 发明人: 方晓鹏 (FANG, Xiaopeng); 中国上海市浦东新区中国 (上海) 自由贸易试验区蔡伦路 1690 号

第 4 幢 201203 (CN)。 王玉玺 (WANG, Yuxi); 中国上海市浦东新区中国 (上海) 自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 201203 (CN)。 杨宏超 (YANG, Hongchao); 中国上海市浦东新区中国 (上海) 自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 201203 (CN)。

(74) 代理人: 上海专利商标事务所有限公司 (SHANGHAI PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE, LLC); 中国上海市徐汇区桂平路 435 号 200233 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA,

(54) Title: MOISTURE REMOVAL DEVICE AND ELECTROPLATING APPARATUS

(54) 发明名称: 水分去除装置和电镀设备

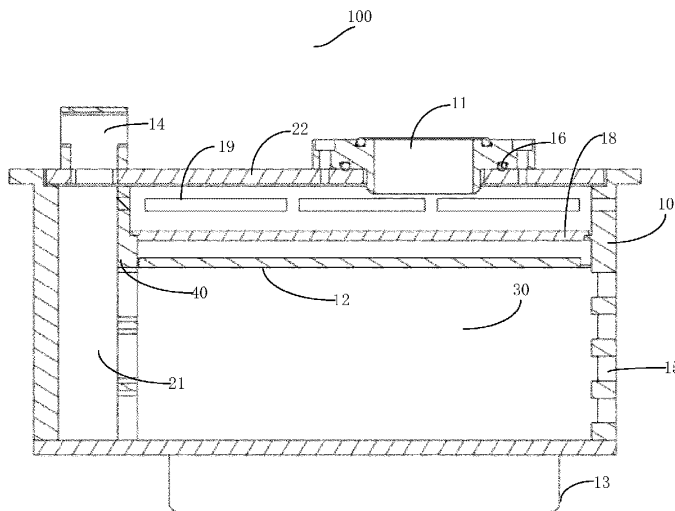


图 1

(57) Abstract: The present application relates to a moisture removal device and an electroplating apparatus. The moisture removal device comprises: a shell, wherein a cover plate is provided at the top of the shell; a first liquid intake line, which is arranged on the cover plate and used for receiving liquid to be subjected to moisture removal; a first flow distribution plate, which is arranged below the cover plate and located in the shell, and is used for distributing the liquid that has entered inside the shell through the first liquid intake line; flow guide plates, which are mounted on the first flow distribution plate, the distributed liquid flowing along the flow guide plates; an air inlet, which is used for supplying air to a gap between adjacent flow guide plates; and an air outlet, which is used for discharging the air that has passed through the gap between the adjacent flow guide plates. By means of the present application, evaporation of

[见续页]

PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

water in an electroplating solution is realized, leading to an increase in the concentration of the electroplating solution, thus enabling the concentration of the electroplating solution to reach a preset standard concentration.

(57) 摘要: 本申请涉及一种水分去除装置和电镀设备。其中，该水分去除装置包括: 壳体，壳体顶部设置有盖板; 第一进液管路，设置于盖板上，用于接收待进行水分去除的液体; 第一分流板，设置于盖板之下且位于壳体内，用于对从第一进液管路进入壳体内部的液体进行分流; 导流板，安装于第一分流板上，分流之后的液体沿导流板流动; 进气口，用于向相邻导流板之间的间隙供应气体; 排气口，用于排出流经相邻导流板之间间隙的气体。通过本申请，实现对电镀液中的水蒸发，提高了电镀液的浓度，使得电镀液的浓度能够达到预设标准浓度。